



SP-355

高导热电子零件灌注胶

UL File No. E354546

特 点

- 通过 UL94 V-0 耐燃等级，低黏度容易混合操作与灌注。
- 低收缩，适合应用在对温度与应力敏感的组件或模块。
- 可常温硬化或加温加速硬化，导热性及电气特性佳。

物 性

		主剂 (A剂)	硬化剂 (B剂)
颜 色 :		白色	黑色
黏 度 :		2,600 – 3,600 cps	3,100 – 4,100 cps
比 重 :		1.72 – 1.74	1.72 – 1.74
重 量 混 合 比 :		100	: 100
混 合 后 颜 色 :		灰黑色	
混 合 后 黏 度 :	@ 25°C	3,000 – 3,800 cps	
混 合 后 比 重 :	@ 25°C	1.72 – 1.74	
可 操 作 时 间 :	@ 25°C	1 – 2 小时	
硬 化 条 件 :		25°C x 18 – 24 小时 或 80°C x 0.5 – 1 小时	
硬 度 :	Shore A	45 – 55	
工 作 温 度 :		-50°C ~ +200°C	
热 传 导 系 数 :		0.8 W/mk (0.46 BTU/hrs/FT ² /FT/°F)	
热 膨 胀 系 数 :	@ 0~100°C	2.06 x 10 ⁻⁴ in/in/°C	
绝 缘 强 度 :		18 kV/mm (457 volts/mil)	
抗 张 强 度 :		1.2 Mpa (174 psi)	
断 裂 伸 长 率 :		80 %	
体 积 电 阻 :		2.2 x 10 ¹⁵ ohm-cm	
绝 缘 常 数 :	1MHz	3.0	
消 散 因 素 :	1MHz	2 x 10 ⁻³	
保 存 期 限 :	@ 25°C	6 个月 (未开封)	

注 意 事 项

1. 部分含有硫、磷、氮元素等有机化合物，可能会抑制或干扰硫化反应，而造成不易硬化。对于有使用脱模剂、含硫材料、或基板上有助焊剂残留物、有机金属化合物等，请先少量试用确定是否有影响，或是灌胶前加强清洁工作。
2. 如果灌注成品内部包裹气泡，建议降低灌胶深度，分次灌胶。或是在灌胶前后对树脂或灌注模块进行真空脱泡，以获得最佳外观。
3. 开封后请尽速用完或是密封，避免受潮。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
 台北: 886-2-26008672 台中: 886-4-25685848
 东莞: 86-769-88188707 苏州: 86-512-66106145

杰研贸易(上海)有限公司
 www.jasdi.com.cn • jasdi@jasdi.com.cn
 TEL: 021-58356975 • FAX: 021-58356976